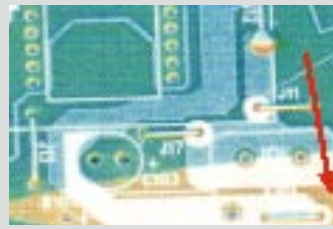


【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 印刷時に S R インクが切れたことにより出来たもの（S R 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 SR 印刷时油墨中断所引起的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Solder resist ink runs out during printing, causing the defect (Solder resist printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

2-1-2-2 SR 接触跡残り / SR 的接触痕迹 / Contact mark on solder resist

【特徴】 S R 表面に接触跡が残されている状態の欠陥。接触物によって様々な形になっている

【特征】 在 SR 表面有接触痕迹的缺陷，不同的接触物留下不同的形状。

【Characteristics】 A contact mark is left on the solder resist surface. The shape of the mark varies depending on the object that makes a contact.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布後～乾燥前に、作業服や装置の一部などに接触したことによる接触痕がそのまま乾燥されて出来たもの（S R 塗布～乾燥工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在涂布后～烘干前 SR 接触到工作服或者装置的局部等，烘干后痕迹原样地显示出来（涂布 SR 后～烘干前）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A contact mark is given by the contact of a part of working uniform or the machine after solder resist is coated and cured.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
防塵服裾の接触跡
顕微鏡倍率 × 100

【注釋】
防尘服下摆的接触痕迹
显微镜倍率 × 100

【Comments】
Contact prints of dust-free garment hem
Magnification: ×100

2-1-2-3 SR 擦れ跡残り / SR 的摩擦痕迹 / Abrasion mark on solder resist

【特徴】 S R 表面に接触物による擦れ跡が残っている状態の欠陥。接触物の形が残されていないので、接触物の特定はし難い

【特征】 在 SR 表面留下被物体摩擦的痕迹。由于没有保存物体的形状，所以难以辨认什么物体。

【Characteristics】 An abrasion mark is left on the solder resist surface. Difficult to identify the object of the contact, as the shape of the object is not left.



【コメント】
顕微鏡倍率 × 20

【注釋】
显微镜倍率 × 20

【Comments】
Magnification: ×20